

深圳市共进电子股份有限公司

关于对外投资暨签署增资协议的补充公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司以自有资金 15,000 万元人民币对上海芯物科技有限公司（以下简称“芯物科技”或“目标公司”）增资，其中 6,708.8608 万元计入目标公司注册资本，剩余金额计入资本公积，本次增资交割完成后，公司将持有目标公司 21.8340%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：临 2023-042）。现就上述公告涉及的投资事项补充说明如下：

一、目标公司业务介绍

芯物科技成立于 2017 年 9 月 13 日，是国家智能传感器创新中心（以下简称“国创中心”）的运营载体。芯物科技当前的主业为传感器相关工艺研发（IP）及传感器应用服务，核心定位是传感器共性技术及先进工艺的研发及产业化，帮助国内相关行业整体健康完善发展，目前芯物科技已建成了国内首个 12 吋智能传感器研发中试线，致力于打造国内领先的智能传感器工艺研发、晶圆制造及产业化服务平台。

二、公司传感器封测业务介绍

公司于 2021 年底开始布局传感器封测业务，聚焦智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试，先后设立控股子公司上海共进微电子有限公司（以下简称“上海微电子”），及上海微电子全资子公司苏州共进微电子有限公司（以下简称“苏州微电子”）。2023 年上半年公司传感器封测收入规模超过 1,200 万元，并成功通过了 12 家客户的认证。

三、本次交易定价政策和定价依据

上海强睿资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了《上海芯物科技有限公司拟非同比例增资所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪强睿评报字[2023]第 3003 号），经资产评估，截至评估基准日 2023 年 4 月 30 日，芯物科技股东全部权益评估值为 2.37 亿元。交易各方以评估报告为基础，经协商一致，最终确定本次交易目标公司的投前估值为 2.37 亿元。公司将根据相关协议进行增资并缴纳出资，同时根据出资比例承担对应的责任，本次对外投资的定价依据符合市场原则，交易公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

目标公司与公司传感封测业务具有协同性。本次增资协议的签署有利于进一步深化公司与芯物科技的合作关系，打造晶圆制造+封测产业链，致力于为客户提供一条龙服务，增强客户粘性。

本次增资完成后，公司占目标公司的持股比例为 21.8340%，且将派出 1 名董事参与芯物科技的经营决策。本次对外投资资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及全体利益的情形。

五、本次对外投资的风险分析

公司以自有资金投资芯物科技，虽已对相关技术、业务和市场进行了充分的分析，但本次投资的标的公司在运营过程中，因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响，经营发展存在不确定性，亦存在一定的投资风险。且本次交易尚需协议各方履行适当审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日